

证券代码：601231
转债代码：113045

证券简称：环旭电子
转债简称：环旭转债

环旭电子股份有限公司 2023 年半年度业绩说明会活动记录

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他
时间	2023 年 9 月 8 日
地点	同花顺路演平台 https://board.10jqka.com.cn/rs/
上市公司 参会人员	魏镇炎（总经理）、仓勇涛（独立董事）、史金鹏（董事会秘书）、刘丹阳（财务总监）
业绩说明会文字互动环节记录	<p>【问题】您好董秘，我想咨询下贵司是否有除墨西哥以外国家或地区投资建厂的规划，谢谢</p> <p>【回答】公司目前除了在墨西哥新建工厂以外，还会在波兰扩建新的厂房，墨西哥、波兰的新建产能预计在 2024 年完成。</p> <p>【问题】2023 年有回购计划吗</p> <p>【回答】公司 2019 年以来已完成三次股票回购计划，后续如有新的回购计划将及时公告。</p> <p>【问题】公司还会回购吗？</p> <p>【回答】公司 2019 年以来已完成三次股票回购计划，后续如有新的回购计划将及时公告。</p> <p>【问题】公司前面提到的汽车电子电动化，请问主要是哪些产品？</p> <p>【回答】公司在汽车电子业务中的“电动化”领域，主要为根据客户需求，以 EMS+或 JDM 方式提供代工制造服务，为客户提供从功率模组、到控制板、再到具体动力总成产品的垂直一</p>

体化制造服务，涉及到的具体产品包括 IGBT/SiC 功率模组、驱动逆变器、BMS、OBC 等产品，服务的客户类型包括 IDM/Fabless 厂商、整车厂、Tier1 厂商。

【问题】 VR AR 这些可以用 sip 吗？

【回答】 SiP 模组具有集成度高、功耗低、可靠性高的特点，非常适合对“轻薄短小”要求很高的电子产品，相信在 AR/VR/MR 产品上有广阔的应用前景。

【问题】 请问公司有 VR、MR、AR 相关的业务吗？

【回答】 公司的 WiFi 模组等已应用于客户的 XR（含 VR/MR/AR）产品。

【问题】 公司有 5g6g 业务吗？

【回答】 公司积极关注通讯技术的发展及迭代，当前为大客户供货 5G 毫米波天线模组。业界预计 6G 网络进入商用要到 2030 年前后，无线通讯相关的 SiP 模组产品在 6G 时代有望得到更广泛的应用。

【问题】 请问公司服务器、交换机相关的业务占比如何？是否有用于 AI 产品？

【回答】 公司“云端及存储类”业务在 2022 年约占公司营收总额的 10%，在 2023 年上半年约占公司营收总额的 8%，其中主要产品包括标准机架服务器/边缘服务器的主机板、高速交换机、数据网卡、SSD 产品、拓展坞等，均可用于 AI、边缘计算、云计算、数据中心等领域的核心设备。

【问题】 请介绍一下公司的“异质整合”技术和这种技术的优势

【回答】 SiP 是一种异构集成术，也可称为“异质整合”，其系统级整合的能力可以集成具有不同技术的组件，例如将模拟和数字电路整合，或将高性能和低功耗组件包含主动和被动元件整合，形成完整的电子系统。SiP 可以集成来自不同制造商的多样组件，实现定制化并选择每个功能的最佳性能组件。这种灵活性和外形可塑性在需要特定功能或专用组件时尤为重要。通过使用封装工艺，实现了对 SiP 中个别组件的系统级测试和优化，最大程度地减少故障风险，提升整体系统产量，进一步增强电子系统的可靠性和稳定性。通过对内凹槽、隔间屏蔽，对外覆形屏蔽，能够有效阻断 SiP 中各个不同 IC 之间的电磁干扰，也能阻断 SiP 外部

其他的电磁干扰。SiP 提供了系统集成的可扩展性选项。制造商可以根据系统要求和未来升级的需要添加或移除组件。这种可扩展性使得产品能够更容易地适应不断变化的市场需求和技术迭代进步。SiP 模组最能满足消费电子产品日益严苛的“轻薄短小”、高集成度、低功耗、高可靠性的要求。

【问题】 请问各位领导，目前贵司在手机端的布局有哪些？是否与国内外品牌厂商都有较多的布局？谢谢。

【回答】 公司目前出货应用至手机的产品主要包括：WiFi 模组、UWB 模组、5G 毫米波模组、指纹辨识模组、SiPlet，服务全球最知名的消费电子品牌厂商。公司也在积极拓展更多智能手机品牌客户的 SiP 模组业务，目前已为美系安卓手机厂商供货 WiFi 模组。

【问题】 有做光伏储能吗

【回答】 公司目前有为客户供货储能相关产品，具有非常好的成长前景。

【问题】 有电子烟业务吗

【回答】 公司目前没有量产的电子烟业务。

【问题】 公司是否有 WiFi7 的业务？相较于 WiFi6，WiFi7 有什么优势；上课没好好听，速度快，间隔短，适用于要求高的物联网项目

【回答】 公司未来将配合客户开发 Wi-Fi 7 相关通讯模组。Wi-Fi 7 是下一代 Wi-Fi 标准，也称为 IEEE 802.11be。它是 Wi-Fi 6 的后继者，提供了更快的速度和更低的延迟。Wi-Fi 7 使用 2.4GHz、5GHz 和 6GHz 的频段，最高速度可达 46 Gbps。Wi-Fi 7 的主要改进包括更好的多用户多输入多输出 (MU-MIMO) 技术、更好的信道利用率、更好的功率管理和更好的安全性。

【问题】 公司是否有 WiFi7 的业务？相较于 WiFi6，WiFi7 有什么优势？

【回答】 公司未来将配合客户开发 Wi-Fi 7 相关通讯模组。Wi-Fi 7 是下一代 Wi-Fi 标准，也称为 IEEE 802.11be。它是 Wi-Fi 6 的后继者，提供了更快的速度和更低的延迟。Wi-Fi 7 使用 2.4GHz、5GHz 和 6GHz 的频段，最高速度可达 46 Gbps。Wi-Fi 7 的主要改进包括更好的多用户多输入多输出 (MU-MIMO) 技术、更好的信道利用率、更好的功率管理和更好的安全性。

	<p>【问题】 Wi-Fi 用在哪些产品？</p> <p>【回答】 目前 Wi-Fi 模组主要应用在智能手机、智能穿戴、平板电脑、笔记本电脑、其他物联网设备中，未来也将更多应用在 XR 产品、游戏机以及智能家居领域。</p> <p>【问题】 除了大客户，公司还有哪些 SiP 客户，主要是哪些产品？</p> <p>【回答】 公司目前在大客户以外的 SiP 模组化业务包括 WiFi 模组、智能穿戴模组、CPU 模组、SoM 模块、其他通讯相关的模组等产品，主要应用于客户的智能手机、智能穿戴产品、笔记本电脑、物联网设备、工业、汽车等领域。</p> <p>【问题】 公司的投资、收购策略是什么？</p> <p>【回答】 公司正持续开展企业创投(CVC)投资，已投资 GaN 芯片、WiFi 6 芯片、ICT 产业基金、SiP 模组产品开发等项目。公司的 CVC 投资和新的并购项目将围绕核心业务领域，尤其是微小化模组、汽车电子、功率电子、工业电子等方面，请持续关注公司发布的公告或新闻。</p> <p>【问题】 请问各位领导，目前公司在智能座舱、自动辅助驾驶方面有什么产品吗？</p> <p>【回答】 公司在智能座舱、智能驾驶方面的产品包括：车载信息娱乐系统控制板、HUD 控制板、NAD 模组、汽车 CPU 模组、车载以太网闸道器、自动驾驶控制器（ASM、TMM、VPM）等。</p> <p>【问题】 能不能介绍一下前面提到的 5g 毫米波业务</p> <p>【回答】 公司积极关注通讯技术的发展及迭代，当前为大客户供货 5G 毫米波天线模组，未来随着全球各国 5G 毫米波基站设施普及率提升，搭载 5G 毫米波的手机、智能电子设备也势必增加。5G 毫米波相较于 Sub-6GHz，传输速度更快，具备更高强度的信号，其更高的带宽，更容易解决用户网络拥堵的问题，更适合在车站、购物中心、机场、体育中心等人口密集的场景应用，能够为用户带来更好的通讯、网络体验。</p> <p>【问题】 公司的主要客户是否有要求在海外投产能</p> <p>【回答】 公司从 2018 年开始启动全球化布局，目前在全球四大洲有 28 个生产据点，努力满足客户在不同区域制造服务的订单需求，目前公司占比最大 SiP 模组业务的主要生产据点布</p>
--	---

	局在中国及越南。
附件清单（如有）	无
日期	2023 年 9 月 8 日